

Sächsischer Arbeitskreis Elektroniktechnologie

Datum: 22. Juni 2011

Veranstalter: Fraunhofer IZFP, Dresden und
Microelectronic Packaging Dresden GmbH

Veranstaltungsort: Fraunhofer IZFP, Dresden
Maria-Reiche-Strasse 2
01109

Thema: Zuverlässigkeit und Qualitätsanalyse von Aufbau- und
Verbindungstechnik für Sensoren und Mikrosysteme

Tagungsprogramm:

Zeit	Programmpunkt	Sprecher
9:30 Uhr	Begrüßung	Prof. Bauer
9:40 Uhr	Vorstellung des Fraunhofer IZFP-Dresden	Dr. Heuer
10:00 Uhr	Vorstellung der Fa. Microelectronic Packaging Dresden	W. Schneider
10:20 Uhr	Kaffeepause	
10:40 Uhr	Zuverlässigkeit von Mikrosystemen, Materialauswahl und Tests	Dr. Röllig
11:00 Uhr	Fachvortrag MPD / aktuelle Trends im Packaging	W. Schneider
11:40 Uhr	Mikro- und Nanoanalytik für die Mikroelektronik	Dr. Köhler
12:00 Uhr	Mittagsimbiss	
13:00 Uhr	Qualitätsanalyse von Klebverbindungen mittels Ultraschallmikroskopie an gedünnten Wafer	Th. Windisch
13:20 Uhr	Zuverlässigkeitsuntersuchungen an 2-poligen Bauelementen unter Schwingungsbelastung	K. Meier
13:50 Uhr	Zerstörungsfreie Analytik für die Elektronik unter dem Dach der NanoEva	Dr. Oppermann/ O. Albrecht
14:10 Uhr	Schlusswort	Prof. Bauer
14:20 Uhr	Kaffeepause	
14:30 Uhr	Parallel: Laborrundgang am IZFP-D (2 Gruppen x15 Pers.)	Dr. Röllig
ca. 16:00 Uhr	Besichtigung des Standortes der MPD	W. Schneider